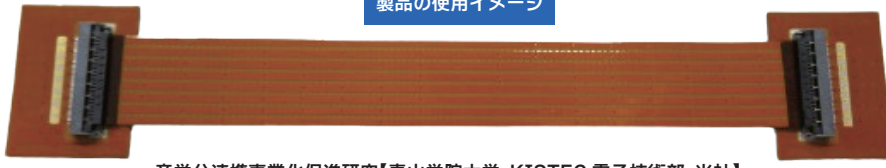
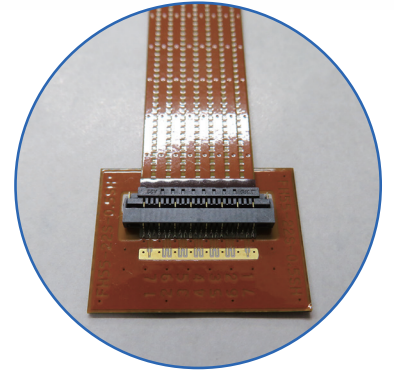


高速伝送 YFC_GS シリーズ

製品の使用イメージ



産学公連携事業化促進研究【青山学院大学、KISTEC 電子技術部、当社】
 〈高速伝送用 FPC の製造技術及び電磁ノイズ低減技術の研究開発〉



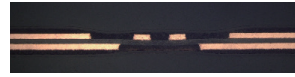
製品特徴

高速伝送 YFC_GS シリーズは、GND スリット構造を採用することにより、従来品(RF シリーズ)と比較して大幅な伝送損失の低減と柔軟性の向上を実現しました

GSM(従来品 RFM 相当)

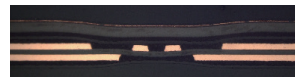
差動信号によるマイクロストリップライン構造

GS シリーズ断面写真

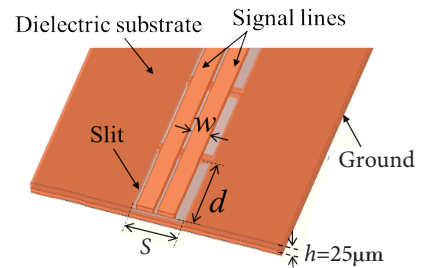


GSS(従来品 RFS 相当)

差動信号によるストリップライン構造(シールド構造)



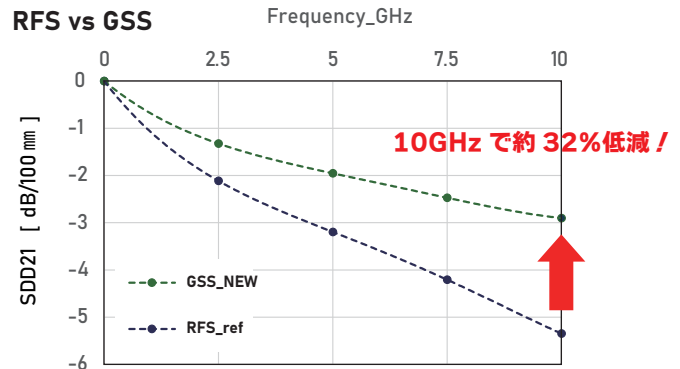
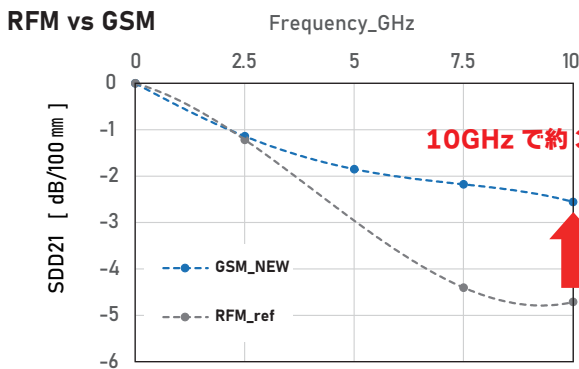
GND スリット構造のイメージ



製品仕様例

層数	: 2 層
ベース材料	: 液晶ポリマー (LCP) 25 μm 厚
カバークोट	: 低誘電カバークोट+必要に応じてシールドフィルム
導体厚み	: 27 μm
インピーダンス整合	: 差動 100Ω±10%
コネクタ端子処理	: 金めっき

両端のコネクタを含めた 100 mm 長の伝送損失

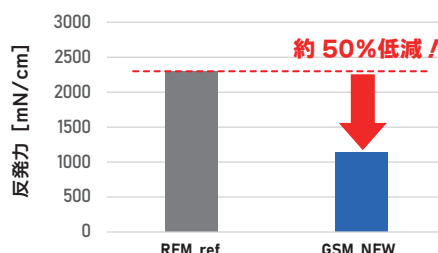


柔軟性の評価 (ループスティフネス評価)

輪状にした FPC ケーブルを潰して反発力を測定



RFM vs GSM



RFS vs GSS

